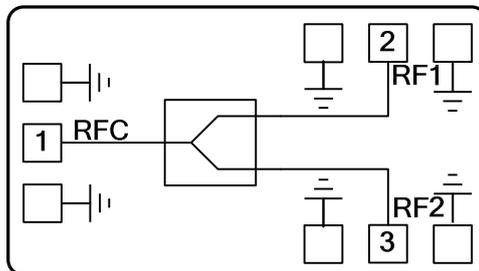




主要特点

- 频率范围: DC - 8 GHz
- 插入损耗: 3.5 dB
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: $1.5 \times 1.5 \times 0.1 \text{ mm}^3$

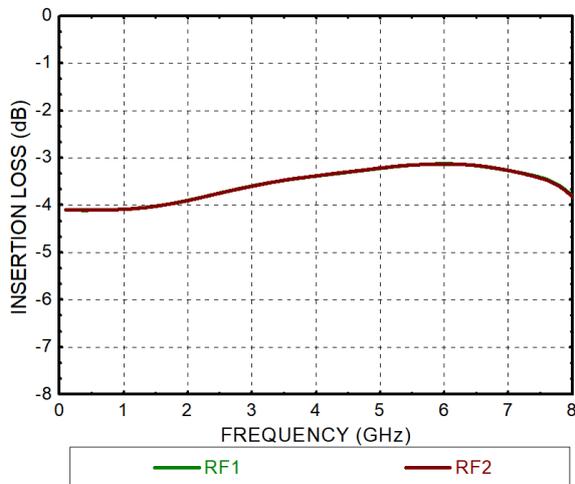
功能框图



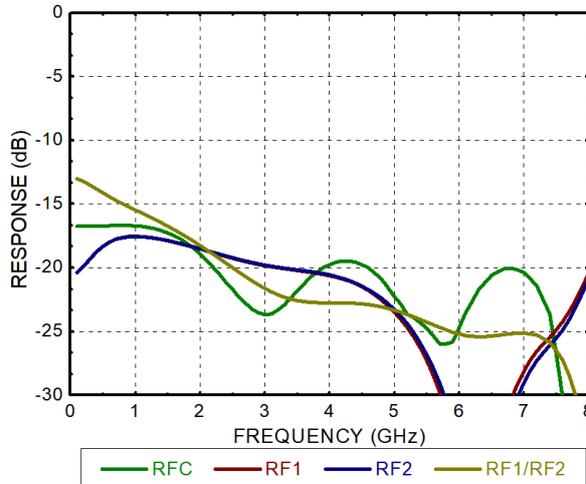
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $P_{in} = 0 \text{ dBm}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC - 8			GHz
插入损耗 (扣除功分欧姆损耗)		3.5		dB
平坦度		± 0.5		dB
隔离度		20		dB
回波损耗		18		dB

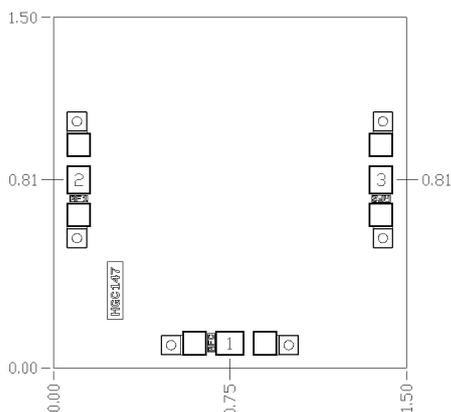
插入损耗



回波损耗



物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
2	RF1	该焊盘是射频支路端
3	RF2	该焊盘是射频支路端
1	RFC	该焊盘是射频公共端



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件, 运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100 um
3. 典型键合焊盘尺寸为 120*100 um²
4. 键合焊盘金属化: 金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息: 材质: SiN+PBO; 厚度: 0.5+1.6um

极限参数

1. 射频输入功率: +35 dBm
2. 储存温度: -65 ~ +150 °C
3. 工作温度: -55 ~ +85 °C